**中国电子材料行业协会覆铜板材料分会**

**关于召开“2025年中国覆铜板行业高层论坛”的通知**

中国电子材料行业协会覆铜板材料分会，拟定于2025年5月14日至16日在江西省景德镇市乐平市“乐平市山水国际酒店”，召开“2025年中国覆铜板行业高层论坛”。

当今世界变乱交织，百年变局加速演进。国际环境复杂、严峻、不确定性加剧，多重危机对全球经济构成叠加冲击；面对新形势、新挑战，我国覆铜板行业如何贯彻“稳中求进、以进促稳、守正创新、先立后破、协同配合”的国家发展总基调，覆铜板产业如何创新开拓、如何抓住机遇，使产业实现质的有效提升和量的合理增长，稳步推进覆铜板产业高质量发展。值此之际，举行“中国覆铜板行业高层论坛”具有重大的现实意义。会议主题为“**向新而行 以质致远**”，将邀请上级主管部门领导、覆铜板行业及上游原材料、下游PCB行业著名专家、企业家围绕大会主题，从产业链与宏观经济、新市场及新技术等多维度，对2025年及未来覆铜板产业发展趋势进行研判。

“2025年中国覆铜板行业高层论坛”由中国电子材料行业协会覆铜板材料分会主办，江西同宇新材料有限公司承办。热忱欢迎业界同仁莅临会议进行交流与研讨。

现将会议有关事项通知如下：

1. **组织单位：**

 指导单位：中国电子材料行业协会

主办单位：中国电子材料行业协会覆铜板材料分会

承办单位：江西同宇新材料有限公司

协办单位：乐平市经济合作交流中心

**二、赞助单位：**

 江西同宇新材料有限公司

同宇新材料（广东）股份有限公司

南通凯迪自动机械有限公司

浙江华正新材料股份有限公司

广东龙宇新材料有限公司

合肥井松智能科技股份有限公司

南通图海机械有限公司

上海博枫贸易有限公司

浙江双元科技股份有限公司

山东圣泉电子材料有限公司

苏州昌和应用材料有限公司

彤程新材料集团股份有限公司

华烁电子材料（武汉）有限公司

成都科宜高分子科技有限公司

陕西宝昱科技工业股份有限公司

芜湖村田精密机械有限公司

宿迁志晟科技有限公司

淮北绿洲新材料有限责任公司

咸阳威迪机电科技有限公司

江苏东材新材料有限责任公司

苏州巨峰新材料科技有限公司

智仑新材料科技（西安）有限公司

武汉意普科技有限责任公司

广东亚镭环境科技股份有限公司

 江西省高硕航宇新材料有限公司

无锡伟一不锈钢有限公司

中国巨石股份有限公司

苏州锦艺新材料科技股份有限公司

上海衡封新材料科技有限公司

汕头超声覆铜板科技有限公司

重庆德凯实业股份有限公司

广东生益科技股份有限公司

南亚新材料科技股份有限公司

九江德福科技股份有限公司

浙江花园新能源股份有限公司

贝高（上海）装备技术有限公司

赞助单位征集中.....

**三、会议日期：**“2025年中国覆铜板行业高层论坛”会期：2025年5月14日～16日。5月14日，全天报到；5月15日，会议报告：8:30～16:30，参观江西同宇新材料有限公司：16:30～18:00 ；5月16日，代表疏散。

**四、会议会址：**酒店名称：乐平市山水国际酒店 地址：江西省乐平市后港镇大山坞666号。

**五、会议日程**（附后）

**六、会议费用：**

费用包括：会务费、资料费、餐饮费等。会员单位代表：已交会员费单位为1500

元/人；未交会员费单位、非会员单位代表为2000元/人。

参会代表可提前将会务费用汇至协会账户，如参会人员有变动，可随后退费或报到现场补交。住宿：参会代表按会议优惠价提前自行与酒店联系预定房间。标间300元/晚/间（含双早），单间：300元/晚/间（含双早），豪华间400元/晚/间（含双早），费用自理。

**预订住宿联系人： 王花 15079872377**

参会代表预先付款方式：

帐 户: 中国电子材料行业协会

开户银行: 工行北京香河园支行

账 号:0200 0191 0900 0125 724

注：提前汇款请在汇款之日将开票信息同会议回执一起发给会务组，收到汇款后即可开票邮寄，汇款时请附言“覆铜板会议会务费”，以便区分；现场现金缴费的请将开票信息同会议回执一起提前发到会务组，以便及时开票。

**七、交通指南：本次会议承办单位提供接送站服务**

昌北国际机场：距离会议酒店约160公里，乘车2小时到达；

景德镇罗家机场：距离会议酒店约62公里，乘车1个小时达到；

南昌西站（高铁站）：距离会议酒店约160公里，乘车2小时到达；

景德镇北站(高铁站)：距离会议酒店约70公里，乘车1小时达到；

乐平北站（高铁站）：距离会议酒店约25公里，乘车30分钟达到。

**接送站时间安排如下：**
　　接站时间：5月14日，12:00～24:00，昌北国际机场、景德镇罗家机场、南昌西站、景德镇北站、乐平北站，每两小时一班中巴车接送参会代表至会议酒店；
　　送站时间：5月16日，8:00、10:00、13:30、16:00，分别安排班车，送参会代表至昌北国际机场、南昌西站、景德镇北站、乐平北站；

请参会代表合理安排出行时间。

**八、其他事项：** 请所有参会代表务必将回执在5月8日前发回秘书处。

**九、联系方式**

CCLA秘书处联系方式：

联 系 人：王晓艳 13609146084 15667246308（协会微信）

联系电话：029-33335234 电子邮箱：ccla33335234@163.com

承办单位联系方式：

 江西同宇新材料有限公司 负责人： 林辽远 13929846166

中国电子材料行业协会覆铜板材料分会

2025年2月24日

**会 议 回执**

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** |  |
| **代表姓名** | **职 务** | **手 机** | **电 话** | **E-mail** | **高铁/飞机****车次/航班** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **是否在“乐平山水国际酒店”住宿？是（ ） 否（ ），已于（ ）月（ ）日预订了单人房（ ）间 、双人房（ ）间。** |
| **开票信息：单 位 名 称：** **纳税人识别号：** |
| **注意** | 1. **因房源有限，需要在“乐平山水国际酒店”住宿的代表，请尽快自行与酒店联系预订房间，与酒店**

**联系时请报覆铜板行业协会，即可享受优惠价格。酒店预定房间联系人：王花 15079872377****2、请参会代表准确填写回执表各项信息，****将回执于5月8日前发至****ccla33335234@163.com****。** |

**会议日程（初稿）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **时 间** | **会议内容** | **地点** | **主持/负责人** |
| 5月14日 | 全天代表报到 | 酒店大堂 | 会务组 |
| 5月15日8:30～12:00 | 主持人介绍参会领导及嘉宾 | 酒店四楼山水厅  | 董榜旗 |
| 中电材协覆铜板材料分会 理事长 **郭江程 致开幕词** |
| 江西省乐平市人民政府 领导 **致词** |
| 中国电子材料行业协会 理事长 **潘林**  **致词** |
| 同宇新材料（广东）股份有限公司 董事长 **张驰** **致欢迎词** |
| 江西省乐平市 领导 **投资环境推介** |
| 国家自然科学基金委高技术研究发展中心 技术总师 **史冬梅** **新材料技术发展现状及态势**  |
| 浙江华正新材料股份有限公司 总经理 CCLA 理事长 **郭江程** **向新而行 以质致远** |
| 中国电子电路行业协会 秘书长  **洪芳 电子电路行业发展思考**  |
| 同宇新材料（广东）股份有限公司 总经理 博士 **张驰** **覆铜板用电子树脂发展现状及创新展望**  |
| 广东生益科技股份有限公司 总工程师 **曾耀德** **高速覆铜板市场发展和主要挑战** |
| 智仑新材料科技（西安）有限公司 常务副总经理 **李刚辉** **低总氯环氧树脂的产业化进展**   |
| 12:00～13:30 | **午 餐** | 酒店一楼自助餐厅 | 王晓艳 |
| 5月15日13:30～16:30 | 武汉意普科技有限责任公司 市场总监 **胡明宇****意普CCD如何以“中国精度”重构覆铜板检测产业链** | 酒店四楼山水厅 | 董榜旗 |
| 中兴通讯股份有限公司 新品导入及材料技术部 部长 **安维** **AI时代low Dk玻璃布的发展趋势与需求**  |
| 中国巨石股份有限公司 总裁助理 **沈国明****中国电子玻纤布现状及发展趋势**  |
| 九江德福科技股份有限公司 总经理 博士 **罗佳** **AI浪潮下的关键材料-电解铜箔解决方案**  |
| 中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会 秘书长 **刘文成** **电子铜箔行业发展现状及展望**  |
| 中国电子材料行业协会覆铜板材料分会 秘书长 **董榜旗** **2024年中国覆铜板行业调查解析**  |
| 中国电子材料行业协会覆铜板材料分会 高级顾问 **师剑英** **ICE改性环氧树脂在覆铜板中的应用**  |
| 5月15日16:30 ～18:00 | 参观江西同宇新材料有限公司 | 公司工厂  | 林辽远 |
| 5月15日18:30～20:00 | 江西同宇新材料有限公司 **招待晚宴**  | 酒店四楼山水厅 | 林辽远 |
| 5月16日 | **代表疏散** |